

**Zur Verstärkung suchen wir ab sofort
für unseren Standort Berlin eine/n engagierte/n**



MITARBEITER IM INTERNEN LABOR (W/M)

Ihre Aufgaben:

- Durchführung von Messmittel-Kalibrierungen
- Dokumentation von Prüfergebnissen und Erstellung von Berichten
- Bewertung der Ergebnisse von Wareneingangsprüfungen
- Programmierung und Durchführung von Messungen an 3D-Videomesssystemen
- Durchführung visueller Prüfungen (Mikroskop)
- Durchführung präparativer metallographischer Analysen (Schliffherstellung und Bewertung)
- Betreuung von Zuverlässigkeitsprüfungen an elektronischen Baugruppen
- Vielseitige Aufgaben im Bereich der Elektronikfertigung

Unsere Anforderungen:

- Technische Ausbildung
- Lesen technischer Zeichnungen
- SAP-Kenntnisse
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Entscheidungskompetenz
- Durchsetzungsvermögen
- Selbständige Arbeitsweise
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeit
- Hohes Maß an Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
- Ausgeprägte Teamorientierung

Sie finden sich bei uns in einem engagierten und kollegialen Team wieder.

Wir bieten Ihnen moderne Infrastruktur, eine Tätigkeit in einer Branche mit Prestige und Entscheidungskompetenz sowie mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Entfaltungsmöglichkeiten.

Interessiert?

Nutzen Sie die Chance auf die Mitarbeit in unserem motivierten Team und senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt per Mail im PDF-Format, an: hr@aemtec.com

exceet Group

Die exceet Group (www.exceet.ch) ist ein internationaler Technologiekonzern, der sich mit insgesamt 700 Mitarbeitern auf die Entwicklung und Fertigung intelligenter, komplexer und sicherer Elektronik spezialisiert hat.

AEMtec GmbH

Die AEMtec GmbH, mit Firmensitz und Fertigungsstätte am renommierten Wissenschafts- und Technologiestandort Berlin Adlershof, bietet modernste Technologien für kundenspezifische komplexe (opto-) elektronische Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Spektrum an Aufbau- und Verbindungstechnologien, wie UBM, Solder Ball Attach, Stud Bumping, Chip on Board, Flip Chip, 3D-Integration und Opto-Packaging. Umfangreiche Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Machbarkeitsstudien zur Aufbau- und Verbindungstechnik, Design und Layout sowie Testequipment-Erstellung bis hin zur Serienproduktion runden das Dienstleistungsspektrum ab.

Wir bieten:

- Flexible Arbeitszeiten
- Raum für Eigenentwicklung
- Selbständiges Arbeiten
- Betriebliche Altersvorsorge
- Anspruchsvolle Aufgaben in einem dynamischen Arbeitsumfeld